

概要

※日本では販売していない製品の情報も含まれます。

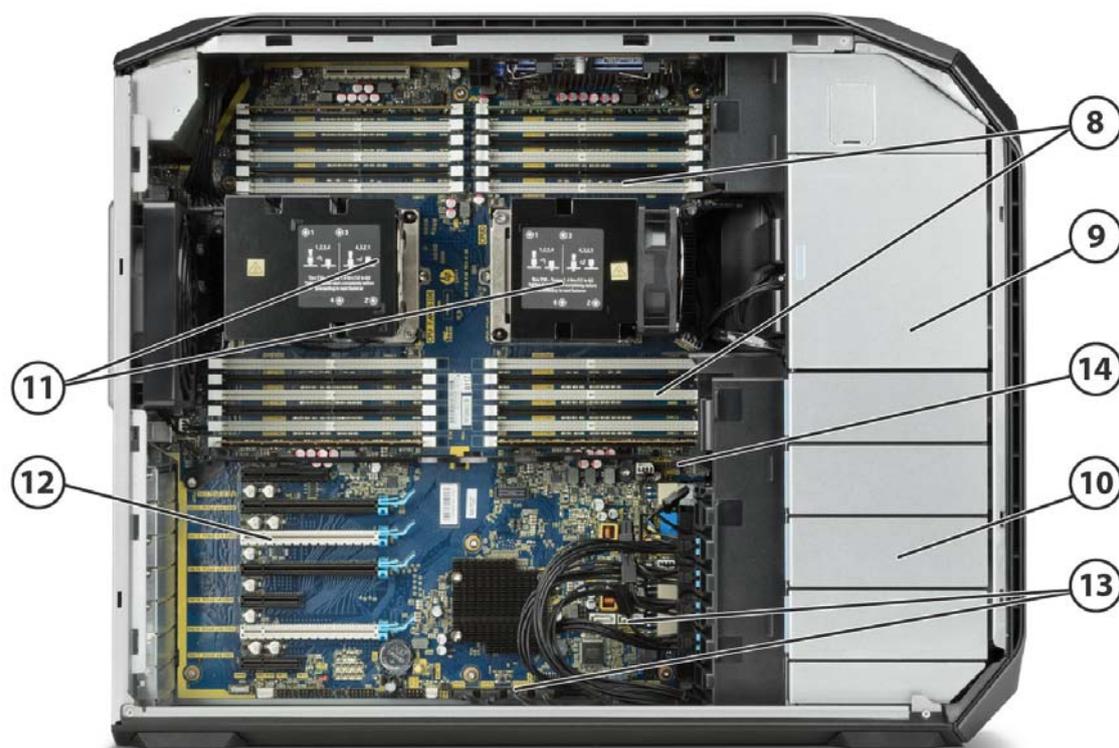
HP Z8 G4 Workstation



正面図

1. フロントハンドル
2. スリム9.5 mmオプティカルドライブベイ
3. 電源ボタン
4. HDD動作ランプ
5. スタンダードフロントI/Oモジュール : USB 3.1 Gen1 × 4 (左端のポートは充電機能付き)
プレミアムフロントI/Oモジュール : USB 3.1 Gen1 × 2、USB 3.1 Gen2 Type-C × 2 (左端のType-Aポートは充電機能付き)
注 : 上記写真はプレミアムフロントI/Oモジュールです
6. メディアカードスロット
7. ヘッドセット × 1

概要



内部図

- 8. DDR4 ECCメモリ用DIMMスロット × 24
- 9. 外付け5.25インチ ベイ × 2および薄型オプティカル
- 10. 内蔵3.5インチ ベイ × 4
- 11. インテル® Xeon®プロセッサ（Skylake SP）ファミリー × 2
- 12.
 - スロット1：PCIe Gen3 x4 – 2nd CPUが取り付けられている場合はPCIe Gen3 x8として動作しません
 - スロット2：PCIe Gen3 x16
 - スロット3：PCIe Gen3 x16 – 2つ目のプロセッサが取り付けられている場合のみ使用可能
 - スロット4：PCIe Gen3 x16
 - スロット5：PCIe Gen3 x4
 - スロット6：PCIe Gen3 x16 – 2つ目のプロセッサが取り付けられている場合のみ使用可能
 - スロット7：PCIe Gen3 x4
- 13. sSATA × 2、SATA（AHCI）ポート × 8
- 14. USB 2.0内蔵ポート × 3、USB 3.0 Gen1内蔵ポート × 1

概要



背面図

- 15. 1125 Wの90%効率電源装置を選択可能
- 16. リアI/O :
 - リア電源ボタン
 - USB 3.0 Gen1 × 6
 - シリアル × 1
 - PS/2キーボードおよびマウス
 - RJ-45 - 内蔵ギガビットLAN × 2
 - オーディオラインイン × 1 (マイクとして再割り当て可能)
 - オーディオラインアウト × 1
 - オプション : 10GbE LANポート × 2

概要

概要

フォームファクター 縦置き時
オペレーティングシステム プリインストール:

- Windows 10 Pro 64 for Workstations
- Linuxに対応（お客様のOSインストールのためにFreeDOS適用）
- Red Hat® Enterprise Linux® Desktopワークステーション（1年サポート付きの使用許諾契約書。プリインストールOSなし）

サポート対象:

- Windows 7 Professional 64ビット
- Red Hat® Enterprise Linux® Desktop 7.4
- SUSE Linux® Enterprise Desktop 12 SP3
- Ubuntu 16.04 LTS

注: Linux®の詳しいOS/ハードウェアサポート情報については、次を参照してください:

http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix（英語サイト）

使用可能なプロセッサ

名前	コア	クロック速度 (GHz)	キャッシュ (MB)	メモリ速度 (MT/s)	ハイパースレディング	インテル®vPro-テクノロジー搭載	インテル®ターボブーストテクノロジー ¹	TDP (W)
インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサ	28	2.5 GHz	38.50	2666	あり	あり	3.8 GHz	205
インテル® Xeon® Platinum 8160 プロセッサ	24	2.1 GHz	33.00	2666	あり	あり	3.7 GHz	150
インテル® Xeon® Gold 6152 プロセッサ	22	2.1 GHz	30.25	2666	あり	あり	3.7 GHz	140
インテル® Xeon® Gold 6154 プロセッサ	18	3.0 GHz	24.75	2666	あり	あり	3.7 GHz	200
インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサ	20	2.4 GHz	27.50	2666	あり	あり	3.7 GHz	150
インテル® Xeon® Gold 6142 プロセッサ	16	2.6 GHz	22.00	2666	あり	あり	3.7 GHz	150
インテル® Xeon® Gold 6136 プロセッサ	12	3.0 GHz	24.75	2666	あり	あり	3.7 GHz	150
インテル® Xeon® Gold 6140 プロセッサ	18	2.3 GHz	24.75	2666	あり	あり	3.7 GHz	140
インテル® Xeon® Gold 6134 プロセッサ	8	3.2 GHz	24.75	2666	あり	あり	3.7 GHz	130
インテル® Xeon® Gold 6132 プロセッサ	14	2.6 GHz	19.25	2666	あり	あり	3.7 GHz	140
インテル® Xeon® Gold 6130 プロセッサ	16	2.1 GHz	22.00	2666	あり	あり	3.7 GHz	125
インテル® Xeon® Gold 6128 プロセッサ	6	3.4 GHz	19.25	2666	あり	あり	3.7 GHz	115
インテル® Xeon® Gold 5120 プロセッサ	14	2.2 GHz	19.25	2400	あり	あり	3.2 GHz	105
インテル® Xeon® Gold 5118 プロセッサ	12	2.3 GHz	16.50	2400	あり	あり	3.2 GHz	105
インテル® Xeon® Gold 5122 プロセッサ	4	3.6 GHz	16.50	2666	あり	あり	3.7 GHz	105
インテル® Xeon® Silver 4116 プロセッサ	12	2.1 GHz	16.50	2400	あり	あり	3.0 GHz	85

概要

インテル® Xeon® Silver 4114 プロセッサ	10	2.2 GHz	13.75	2400	あり	あり	3.0 GHz	85
インテル® Xeon® Silver 4112 プロセッサ	4	2.6 GHz	8.25	2400	あり	あり	3.0 GHz	85
インテル® Xeon® Silver 4108 プロセッサ	8	1.8 GHz	11.00	2400	あり	あり	3.0 GHz	85
インテル® Xeon® Bronze 3106 プロセッサ	8	1.7 GHz	11.00	2133	なし	あり	N/A	85
インテル® Xeon® Bronze 3104 プロセッサ	6	1.7 GHz	8.25	2133	なし	あり	N/A	85

¹ この列に示されている仕様は以下を表しています：（すべてのコアの最大ターボステップ数、1つのコアの最大ターボステップ数）。ターボブーストステップは、100 MHz きざみで発生します。ターボ機能を持たないプロセッサは「N/A」と表されています。

使用可能なプロセッサ

免責事項

2つのプロセッサを注文する場合、2つ目のプロセッサは1つ目と同じである必要があります。Intelのプロセッサ番号は、より高いパフォーマンスを評価するものではありません。プロセッサ番号は、異なるプロセッサ ファミリー間ではなく、各プロセッサ ファミリー内で機能を区別します。詳細については、http://www.intel.com/products/processor_number/（英語サイト）を参照してください。

マルチコアは、特定のソフトウェア製品のパフォーマンス向上を意図して設計されています。一部のお客様またはソフトウェア アプリケーションは、このテクノロジーの使用によって恩恵を受けません。パフォーマンスおよびクロック周波数は、アプリケーションの作業負荷とハードウェアおよびソフトウェアの構成によって異なります。Intelのナンバリング、ブランド設定、または命名は、より高いパフォーマンスを評価するものではありません。

色 黒

互換性 なし

拡張スロット（詳しくは、スロット1：

システム ボードのセクションを参照してください）

スロット2：
PCIe Gen3 x16

スロット3：
PCIe Gen3 x16 - 2つ目のプロセッサが取り付けられている場合のみ使用可能

スロット4：
PCIe Gen3 x16

スロット5：
PCIe Gen3 x4

スロット6：
PCIe Gen3 x16 - 2つ目のプロセッサが取り付けられている場合のみ使用可能

スロット7：
PCIe Gen3 x4

注： 上のPCIe x4およびPCIe x8コネクタはオープン エンドであるため、PCIe x16カードをスロットに取り付けることができます。

注： Thunderbolt 3 PCIeカードのサポートは2018年の前半に入手可能

概要

拡張ベイ（詳しくは、[ストレージのセクションを参照してください](#)）
内蔵3.5インチベイ × 4（4つのすべてに音響減衰レールアセンブリが装着済み）
外付け5.25インチベイ × 2（175 mmの深さ制限）

専用の9.5 mmスリム オプティカルドライブベイ × 1

前面I/O

- スタンダード：USB 3.1 Gen1 Type-Aコネクタ × 4左端のコネクタは充電機能付き、コンボヘッドセット × 1、オプションメディアカードスロット × 1
- プレミアム：USB 3.1 Gen1 Type-Aコネクタ × 2左端のコネクタは充電機能付き、USB 3.1 Gen2 Type-Cコネクタ × 2、コンボヘッドセット × 1、オプションメディアカードスロット × 1

内蔵I/O

内蔵スロット1 CPU1：PCIe Gen3 x8 - 常に使用可能
内蔵スロット2 CPU2：PCIe Gen3 x8 - 2nd CPUが取り付けられている場合に使用可能
1つの2x5ヘッダーで使用可能なUSB 2.0ポート × 2
1x6ヘッダーで使用可能なUSB 2.0ポート × 1
USB 3.1 Gen1 × 1、および2x6ヘッダーで使用可能なUSB 2.0ポート × 1

注：2x5ヘッダーは、1つのHP内蔵USBポートキット（EM165AA）を使用して標準（Type-A）USB 2.0コネクタに変換できます。このポートキットは、2x5ヘッダーの半分を使用します。

1x6ヘッダーは、1つのHP内蔵USBポートキット（EM165AA）を使用して標準（Type-A）USB 2.0コネクタに変換できます。このポートキットは、ヘッダー上の5ピンの位置を使用します。

2x6ヘッダーは、1つのHP内蔵USBポートキット（EM165AA）を使用して標準（Type-A）USB 2.0コネクタに変換できます。
このポートキットは、2x6ヘッダーの半分を使用します。

背面I/O

USB 3.1 Gen1（またはUSB 3.0） × 6、シリアル × 1、PS/2キーボードおよびマウス、RJ-45 - 内蔵ギガビットLAN × 2、オーディオラインイン × 1（マイクとして再割り当て可能）、オーディオラインアウト × 1

オプション：RJ-45 - 10GbE LANポート × 2

サポートされる
インターフェイス

10チャネルSATA 6.0 Gb/sインターフェイス
SATAドライブに使用可能な工場出荷時に内蔵されるRAID（RAID 0、1、5、および10）
内蔵USB 3.1 Gen1、USB 3.1 Gen2、USB 2.0

オンボードRAIDサポート

SATA RAID 0ストライプアレイ構成
SATA RAID 1ミラーアレイ構成
SATA RAID 10ストライプ/ミラーアレイ構成
SATA RAID 5パリティアレイ構成

シャーシ寸法

（高さ × 幅 × 奥行き）

設置面積： H：444.5 mm
W：215.9 mm
D：551.2 mm（サービスパネルの背面まで測定）
最大： H：444.5 mm
W：215.9 mm
D：555.2 mm（背面シャーシファンのエンボスまで測定）

パッケージ寸法

H：636 mm
W：332 mm
D：734 mm

ラック寸法

5U

質量

正確な質量は構成によって異なります（システム質量のみ）。
最小：22.4 kg
通常：23.7 kg
最大：31.7 kg

動作保証温度

動作時：5 ~ 35°C

概要

非動作時：-40 ~ 60°C

湿度

動作時：動作時：10 ~ 85%のRH、結露なし、35°C最大湿球
非動作時：10 ~ 90%、結露なし、35°C最大湿球

動作保証高度（非加圧）

動作時：3,048 m
非動作時：9,144 m

注：1524 m（5,000フィート）を超える海拔では、最大動作温度は、高度が305 m（1,000フィート）増加するごとに1°C（1.8°F）下がります。

電源装置

以下のどれかを選択できます。※日本では1125Wのみとなります。
1125W/100V/15A 90%効率のワイドレンジ、アクティブな電圧自動補正機能
電力供給システムには、6+2ピングラフィックス電源ケーブル×4が含まれています。

1450W/100V/15A 90%効率のワイドレンジ、アクティブな電圧自動補正機能
電力供給システムには、6+2ピングラフィックス電源ケーブル×4が含まれています。

1700W/200V/10A 90%効率のワイドレンジ、アクティブな電圧自動補正機能
電力供給システムには、6+2ピングラフィックス電源ケーブル×4が含まれています。

注：1125W/100V/15A（200 Vの入力電圧で1450 W）電源装置はまた、入力電圧が105 Vを超える場合に1275 Wの出力電力を供給することもできます。入力電圧が105 V未満であっても、何らかの理由により90 Vを超える場合、引き出される最大出力は1125 Wになります。1275 Wの出力電力が必要な場合は、無停電電源装置（UPS）の使用を強くおすすめします。

1125W電源装置はまた、入力電圧がすべての条件で200 Vを超える場合に1450 Wの出力電力を供給することもできます。

1450W/100V/15A（200 Vの入力電圧で1700 W）電源装置はまた、入力電圧が105 Vを超える場合に1550 Wの出力電力を供給することもできます。入力電圧が105 V未満であっても、何らかの理由により90 Vを超える場合、引き出される最大出力は1450 Wになります。1550 Wの出力電力が必要な場合は、無停電電源装置（UPS）の使用を強くおすすめします。

1450W電源装置はまた、入力電圧がすべての条件で200 Vを超える場合に1700 Wの出力電力を供給することもできます。

Z8 G4電源供給装置の効率に関するレポートについては、このリンクを参照してください：

1125 W - リンク：

https://plugloadsolutions.com/psu_reports/HP%20Inc_DPS-1125BB%20A_1125W_ECOS%204825_Report.pdf
（英語サイト）

1450 W - リンク：

https://plugloadsolutions.com/psu_reports/HP%20Inc_DPS-1450AB%20A_1450W_ECOS%204826_Report.pdf
（英語サイト）

ワークステーションISV認定

以下の最新の認定一覧を参照してください。

<http://www.hp.com/united-states/campaigns/workstations/partnerships.html>（英語サイト）

サポートされるコンポーネント

プロセッサ

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット製品番号	サポートに関する注
インテル® Xeon® プロセッサ スケーラブルファミリー				
インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサ	Y	Y	1XM54AA	
インテル® Xeon® Platinum 8160 プロセッサ	Y	Y	1XM56AA	
インテル® Xeon® Gold 6152 プロセッサ	Y	Y	1XM57AA	
インテル® Xeon® Gold 6154 プロセッサ	Y	Y	1XM58AA	
インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサ	Y	Y	1XM59AA	
インテル® Xeon® Gold 6142 プロセッサ	Y	Y	1XM61AA	
インテル® Xeon® Gold 6136 プロセッサ	Y	Y	1XM62AA	
インテル® Xeon® Gold 6140 プロセッサ	Y	Y	1XM64AA	
インテル® Xeon® Gold 6134 プロセッサ	Y	Y	1XM66AA	
インテル® Xeon® Gold 6132 プロセッサ	Y	Y	1XM67AA	
インテル® Xeon® Gold 6130 プロセッサ	Y	Y	1XM68AA	
インテル® Xeon® Gold 6128 プロセッサ	Y	Y	1XM69AA	
インテル® Xeon® Gold 5120 プロセッサ	Y	Y	1XM70AA	
インテル® Xeon® Gold 5118 プロセッサ	Y	Y	1XM71AA	
インテル® Xeon® Gold 5122 プロセッサ	Y	Y	1XM72AA	
インテル® Xeon® Silver 4116 プロセッサ	Y	Y	1XM73AA	
インテル® Xeon® Silver 4114 プロセッサ	Y	Y	1XM74AA	
インテル® Xeon® Silver 4112 プロセッサ	Y	Y	1XM75AA	
インテル® Xeon® Silver 4108 プロセッサ	Y	Y	1XM76AA	
インテル® Xeon® Bronze 3106 プロセッサ	Y	Y	1XM77AA	
インテル® Xeon® Bronze 3104 プロセッサ	Y	Y	1XM78AA	

* マルチコアは、特定のソフトウェア製品のパフォーマンス向上を意図して設計されています。一部のお客様またはソフトウェアアプリケーションは、このテクノロジーの使用によって恩恵を受けません。64ビットのコンピューティングシステムが必要です。パフォーマンスは、ハードウェアおよびソフトウェア構成によって異なります。インテルのナンバリング、ブランド設定、または命名は、より高いパフォーマンスを評価するものではありません。

モニター/
ディスプレイ

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット製品番号	サポートに関する注
HP Zディスプレイ Z22n G2		Y	1JS05AA	
HP Zディスプレイ Z23n G2		Y	1JS06AA	
HP Zディスプレイ Z24i G2		Y	1JS08AA	
HP Zディスプレイ Z24n G2		Y	1JS09AA	
HP Zディスプレイ Z24nf G2		Y	1JS07AA	
HP Zディスプレイ Z27n G2		Y	1JS10AA	
HP Zディスプレイ Z27s (4Kディスプレイ)		Y	J3G07AA	
HPのすべてのオペレーティングシステムでサポート 画面サイズは対角線を測定				

ストレージ/ハードディスクドライブ



サポートされるコンポーネント

SASハードディスク ドライブ	HPワークステーション用のSASハードディスク ドライブ	工場出荷時 に設定	オプション キット	オプションキット 製品番号	サポートに 関する注
	HP 300GB 15k SAS SFF	Y	Y	L5B74AA	
注： SASコントローラー アドインカードが必要					

SATAハードディスク ドライブ	工場出荷時 に設定	オプション キット	オプションキット 製品番号	サポートに 関する注
HPワークステーション用のSATA（シリアルATA） ハードディスク ドライブ				
500GB SATA 7200RPM 6Gb/s 3.5インチHDD	Y	Y	LQ036AA	
500GB SATA 7200RPM 6Gb/s OPAL2 SFF 3.5インチHDD	Y	Y	D8N29AA	
1TB SATA 7200RPM 3.5インチHDD	Y	Y	LQ037AA	
2TB SATA 7200RPM HDD	Y	Y	QB576AA	
4TB SATA 7200RPM Ent 3.5インチHDD	Y	Y	K4T76AA	
注：				
最大5台の3.5インチ7200 rpm SATAドライブ：500 GB、1.0、2.0、4.0 TB。合計最大20 TB				

サポートされるコンポーネント

SATAソリッドステート ドライブ

	工場出荷時 に設定	オプション キット	オプション キット 製品番号	サポートに 関する注
ワークステーション用のHPソリッドステートドライブ (SSD)				
HP 256GB SATA SSD	Y	Y	A3D26AA	
HP 512GB SATA SSD	Y	Y	D8F30AA	
HP 1TB SATA SSD	Y	Y	F3C96AA	
HP 2TB SATA SSD	Y	Y	Y6P08AA	

PCIeソリッドステート ドライブ

	工場出荷時 に設定	オプション キット	オプション キット 製品番号	サポートに 関する注
HPワークステーション用のPCIe SSD				
HP Z Turboドライブ256GB MLC Z8G4 SSDモジュール	Y	Y	1PD50AA	
HP Z Turboドライブ512GB MLC Z8G4 SSDモジュール	Y	Y	1PD51AA/AT	
HP Z Turboドライブ1TB MLC Z8G4 SSDモジュール	Y	Y	1PD52AA/AT	
HP Z Turboドライブ256GB TLC Z8G4 SSDモジュール	Y	Y	1PD53AA	
HP Z Turboドライブ512GB TLC Z8G4 SSDモジュール	Y	Y	1PD54AA/AT	
HP Z Turboドライブ1TB TLC Z8G4 SSDモジュール	Y	Y	1PD55AA	
HP Z Turboドライブ256GB SED Z8G4 SSDモジュール	Y	Y	2SA34AA	
HP Z Turboドライブ512GB SED Z8G4 SSDモジュール	Y	Y	2SA36AA	
HP Z TurboドライブQuad Pro				
HP Z TurboドライブQuad Pro 2x256GB PCIe SSD	Y	Y	N2M98AA	1
HP Z TurboドライブQuad Pro 2x512GB PCIe SSD	Y	Y	N2M99AA	1
HP Z TurboドライブQuad Pro 2x1TB PCIe SSD	Y	Y	T9H99AA	1
HP Z TurboドライブQuad Pro 256 GB SSDモジュール	N	Y	N2N00AA	2
HP Z TurboドライブQuad Pro 512GB SSDモジュール	N	Y	N2N01AA	2
HP Z TurboドライブQuad Pro 1TB SSDモジュール	N	Y	T9J00AA	2

注1 : デュアルM.2 SSDモジュールおよびキャリア

注2 : M.2 SSDモジュールのみ、Quad Proキャリアに取り付けられるように設計されている

サポートされるコンポーネント

* ストレージドライブの場合、GB = 10億バイトです。TB = 1兆バイトです。実際のフォーマット済み容量は少なくなります。システムリカバリソフトウェア用に最大30 GBのシステムディスクが予約されています。

ハードディスクドライブ コントローラー	工場出荷時 に設定	オプショ ンキット	オプション キット 製品番号	サポートに 関する注
SASコントローラー				
MicroSemi SmartHBA2100-4i4e SASコントローラー	Y	Y	1FV90AA	

グラフィックス

	工場出荷時 に設定	オプショ ンキット	オプション キット 製品番号	サポートに 関する注	サポート される カード枚数
グラフィックスケーブルアダプター					
HP miniDP - DPアダプター	Y	Y			
HP miniDP - DPアダプター (2パック)	Y	N			
HP miniDP - DPアダプター (4パック)	Y	N			
HP miniDP - DPアダプター (8パック)	Y	N			
HP DisplayPort - デュアル リンク DVIアダプター	Y	Y	NR078AA		
HP DisplayPort - DVI-Dアダプター	Y	Y	FH973AA		
HP DisplayPort - DVI-Dアダプター (2パック)	Y	N			
HP DisplayPort - DVI-Dアダプター (4パック)	Y	N			
HP DisplayPort - DVI-Dアダプター (6パック)	Y	N			
HP DisplayPort - VGAアダプター	Y	Y	AS615AA		
HP DisplayPort - HDMIアダプター	Y	Y	K2K92AA		
NVIDIA SLIグラフィックス コネクタ	Y	Y			
NVIDIA SLI 2スロットグラフィックス コネクタ	Y	Y	2YY84AA		
エントリー3D					
NVIDIA® Quadro® P400 1st GFX 2 GBグラフィックス	Y	Y	1ME43AA/AT		2
NVIDIA® Quadro® P600 1st GFX 2 GBグラフィックス	Y	Y	1ME42AA/AT		2
AMD FirePro® W2100 2GBグラフィックス	Y	Y	J3G91AA/AT		2
ミッドレンジ3D					
NVIDIA® Quadro® P1000 1st GFX 4 GBグラフィックス	Y	Y	1ME01AA/AT		4
NVIDIA® Quadro® P2000 1st GFX 5GBグラフィックス	Y	Y	1ME41AA/AT		4
AMD Radeon® Pro WX 3100 4GBグラフィックス	Y	Y	2TF08AA		4
AMD Radeon® Pro WX 4100 4GBグラフィックス	N	Y	Z0B15AA/AT		4
ハイエンド3D					
NVIDIA® Quadro® P4000 1st GFX 8GBグラフィックス	Y	Y	1ME40AA/AT		3
NVIDIA® Quadro® P5000 1st GFX 16GBグラフィックス	Y	Y	Z0B13AA/AT		3
NVIDIA® Quadro® P6000 1st GFX 24GBグラフィックス	Y	Y	Z0B12AA/AT		3
AMD Radeon® Pro WX 7100 1st GFX 8 GB グラフィックス	Y	Y	Z0B14AA/AT		3
NVIDIA® Quadro® Sync II	Y	Y	1WT20AA		

サポートされるコンポーネント

注：NVIDIA® Quadro® GP100およびAMD Radeon® Pro WX 9100のサポートは2018年の前半に入手可能

メモリ	CTO	工場出荷時に 設定	オプション キット	オプション キット 製品番号	サポートに 関する注
DDR4-2666 ECCレジスタ付きDIMM					
	8GB (1x8GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	Y	Y	1XD84AA/AT	
	16GB (1x16GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	N	Y	1XD85AA/AT	
	32GB (1x32GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	N	Y	1XD86AA/AT	
	64GB (1x64GB) DDR4-2666 ECC LRメモリ	N	Y	1XD87AA	

注：

HP Z8 G4 Workstationでサポートされるメモリ構成の詳細については、このドキュメントの「システム技術仕様-システムボード」セクションを参照してください。

スリープ (S3状態) のサポート：

- スリープ (S3状態) は、HPで検証および認定されていない64GB LR DIMMではサポートされない可能性があります。
- スリープ (S3状態) は、128GB LR DIMMではサポートされていません。

最適なパフォーマンスを得るためには、6つのメモリチャンネル全体でDIMMを均等に分布させてください。

各プロセッサは、DDR4メモリのチャンネルを最大6つサポートします。十分なパフォーマンスを実現するには、少なくとも1つのDIMMが各チャンネルに挿入されている必要があります。

CPUは、メモリクロックの速度を決定します。システムで2400 MT/秒対応のCPUが使用されている場合、メモリの最大実行速度は、メモリの指定されている速度にかかわらず2400 MT/秒です。

MT/秒 = 1秒あたり100万回の転送

LR DIMMとレジスタ付きDIMMを混在させることはできません。システムが正常に機能しなくなります。

Z8 G4は、DDR4メモリでのみ動作するように設計されています。DDR3メモリではシステムが機能しません。

マルチメディアおよびオーディオデバイス

サポートされるコンポーネント

マルチメディアおよびオーディオ デバイス

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット製品番号	サポートに関する注
内蔵Realtek HD ALC221オーディオ	Y	N		

オプティカルおよびリムーバブルストレージ

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット製品番号	サポートに関する注
HPオプティカルドライブ (スリムライン)				
HP 9.5 mmスリムブルーレイディスクライター	Y	Y	K3R65AA	1
HP 9.5 mmスリムDVD ROM	Y	Y	K3R63AA	1
HP 9.5 mmスリムDVDライター*	Y	Y	K3R64AA	1
HP SDカードスロット				
HP SD 4カードスロット	Y	Y	Y0L99AA	

注1 : Z8 G4にオプティカルドライブを取り付けるには、5.25インチ外付けベイアダプターが必要です。

*実際の速度は異なる場合があります。DVD-RAM (DVDライター) のサポートはありません。市販のDVDムービーまたはその他の著作権で保護されているマテリアルのコピーは禁止されています。オリジナルのマテリアルの作成や格納およびその他の合法的使用を意図しています。二重層ディスクは、単一層ディスクよりも多くのデータを格納できます。ただし、このドライブで書き込んだ二重層ディスクは、多くの既存の単一層DVDドライブおよびプレーヤーとは互換性がない場合があります。

ブルーレイでは、特定のディスク、デジタル接続、互換性、またはパフォーマンスに関する問題が発生する場合がありますが、これによって製品が故障することはありません。すべてのシステム上での完全な再生は保証されていません。一部のブルーレイタイトルは、再生するためにDVIまたはHDMIによるデジタル接続やHDCP対応のディスプレイが必要になる場合があります。このワークステーションではHD-DVDムービーは再生できません。

ネットワークおよび通信

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット製品番号	サポートに関する注
HP i350-T2 PCIeデュアルポートギガビットNIC	Y	Y	V4A91AA	
Intel® i350-T4 PCIe 4ポートギガビットNIC	N	Y	W8X25AA	
インテル® Ethernet I210-T1 PCIe x1 Gb NIC	Y	Y	E0X95AA	
インテル® X550-T2 10GbEデュアルポートNIC	Y	Y	1QL46AA	
インテル® X710-DA2 10GbE SFP+デュアルポートNIC	Y	Y	1QL47AA	
インテル® 8265 802.11 a/b/g/n/ac + BT PCIe	Y	Y	1QL48AA	
10GBASE-TデュアルNICモジュールZ6/8 G4	Y	Y	1QL49AA	
HP 10GbE SFP+ SR 1stトランシーバー	Y	Y	C3N53AA	

ラックおよび物理セキュリティ



サポートされるコンポーネント

ラックおよび物理セキュリティ

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット製品番号	サポートに関する注
セキュリティケーブル、ケンジントン社製ロック対応	N	Y	PC766A	
HPシャーシ侵入センサー	Y	N		1
HP Z640/Z840/Z8G4ラック レールキット	N	Y	2FZ77AA	
HP Z8ラック レール アップグレードキット	N	Y	2FZ76AA	
HPセキュリティ ロック ケーブル (施錠式) 10 mm	N	Y	T1A62AA	

注1：すべてのシステムで標準

入力デバイス

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット製品番号	サポートに関する注
ビジネス スリムPS/2有線キーボード	Y	Y	N3R86AA	
USBビジネス スリム有線キーボード	Y	Y	N3R87AA	
3Dconnexion CADMouse	Y	Y	M5C35AA	
HPオプティカルUSBマウス	Y	Y	QY777AA	
HP PS/2マウス	Y	Y	QY775AA	
USB 1000dpiレーザー マウス	Y	Y	QY778AA	

その他のハードウェア

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット製品番号	サポートに関する注
HP内蔵USBポートキット	N	Y	EM165AA	注1
HP eSATA PCIケーブルキット	Y	Y	GM110AA	注2
HPオプティカルベイHDD取り付けカバー	N	Y	NQ099AA	注3
HP 2.5インチHDD/SSD 2-in-1 ODDベイ ブラケット	N	Y	K4T74AA	注4
HP Zプレミアム前面I/O USB-A × 2 USB-C × 2	N	Y	1XM32AA	
HP電源コードキット	Y	N		
HPワークステーション マウスパッド	Y	N		日本のみ
HP国際エネルギー スター®認定構成	Y	N		

注1：HP内蔵USBポートキットには、1つのUSB 2.0タイプAコネクタが付属しています。

注2：ホットプラグ/ホットスワップはeSATAではサポートされていません

注3：NQ099AAは工場で、または製品購入後オプション（AMO）ドライブを購入したときに、4台を超える3.5インチHDDを取り付けるために使用されます

注4：K4T74AAは工場で、または製品購入後オプション（AMO）ドライブを購入したときに、4台を超える2.5インチHDD/SSDを取り付けるために使用されます

ソフトウェア

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット製品番号	サポートに関する注
Sobeyビデオ編集SW	Y	N		中国のみ
SW HP RGS for Z	Y	N		

サポートされるコンポーネント

サポートされるコンポーネント

オペレーティング システム

Windows 10 Pro 64ビット

64ビット版Windows 7 Professional

HP Linux® Installer Kit

Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL) ワークステーション - 使用許諾契約書 (1年)

注1 : この2つ目のOSは、最初のOSとしてHP Linux® Installer Kitとともに注文する必要があります。

注2 : RHEL 6および7、SUSE Linux® Enterprise Desktop 11、およびUbuntu 14.04の64ビットOSバージョン用のドライバーを含みます。

サポートに関する注

注2

注1

システム技術仕様

システムボード

システムボード カスタム フォーム ファクター、16.34インチ × 15.25インチ (415 mm × 387.2 mm)

フォームファクター

プロセッサースocket デュアルFCLGA3647 (ソケットP)

CPUバス速度 UPI : 最大10.4 GT/秒 (プロセッサによって異なります)

チップセット インテル® C622 チップセット

スーパーI/O Nuvoton SIO15

コントローラー

メモリ拡張スロット 24スロット (CPUあたり12スロット)

サポートされるメモリの種類 DDR4 R-DIMM (レジスタ付き)、ECC : 8 GB、16 GB、および32 GB

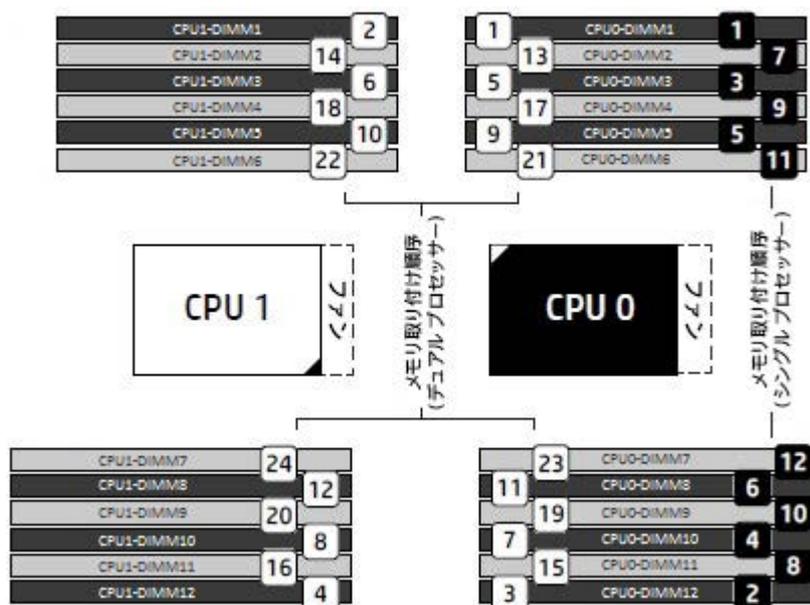
DDR4 LR-DIMM (低負荷)、ECC : 64 GB (128 GBおよび256 GBは後日追加)

メモリモード NUMA (Non-Uniform Memory Architecture)、メモリ ノード インターリーブ

サポートされるメモリの速度 2133 Mt/秒、2400 MHz、および2666 MT/秒

メモリ取り付け順序 :

シングルおよびデュアル プロセッサ構成の取り付け順序



最大メモリ

RDIMMを使用して最大768 GBをサポートします

LRDIMMを使用して最大3 TBをサポートします*

サポートされるメモリ構成

ECCレジスタ付きDIMMのみがサポートされます。

- RDIMM (レジスタ付き) およびLR DIMM (低負荷) メモリを混在させることはできません。システムに取り付けられているすべてのメモリがRDIMMまたはLR DIMMのどちらかである必要があります。
- 対応するプロセッサが取り付けられていない場合は、メモリ モジュールをメモリ スロットに取り付けしないでください。
- メモリ モジュールが1つのプロセッサのみに対して取り付けられるデュアル プロセッサ構成はサポートされていません。

注

32ビット オペレーティング システムがインストールされているシステムの場合、アクセス可能な最大システムメモリは4GBです。

システム技術仕様

Microsoft Windows 7 (Ultimate、Enterprise、またはPro) がインストールされているシステムの場合、アクセス可能な最大システムメモリは192 GBです。

スリープ (S3状態) のサポート :

- スリープ (S3状態) は、HPで検証および認定されていない64 GB LR DIMMではサポートされない可能性があります。
- スリープ (S3状態) は、128 GB LR DIMMではサポートされていません。

Z8 G4は、初期リリースでは最大1.5 TBをサポートします。

* 3 TBのシステムメモリは後日リリース予定

PCI Expressコネクタ

PCIe Gen3 x16 (ラッチ付き) × 2

PCIe Gen3 x16 (ラッチ付き) × 2

- オプションの2nd CPUが取り付けられている場合のみ使用可能。

PCIe Gen3 x8オープンエンドコネクタ × 1

- 1CPU構成時はPCIe Gen2 x4スロットとして動作
- 2CPU構成時はPCIe Gen3 x8スロットとして動作

PCIe Gen3 x4オープンエンドコネクタ × 2

サポート対象のドライブ
SATA
インターフェイス

sSATA @6Gb/s × 2、RAID 0、1、およびNCQをサポートします。

sSATA @6Gb/s × 8、RAID 0、1、5、10、およびNCQをサポートします。

工場出荷時に内蔵されるRAIDはMicrosoft Windowsのみです。

外部SATA (eSATA) *

オプションのeSATA*製品購入後オプションケーブルキットで構成可能なすべてのSATAおよびsSATAポートでサポートされます

*ホットプラグ/ホットスワップはeSATAではサポートされていません

工場出荷時設定のRAID SATA : RAID 0、1、10

内蔵グラフィックス なし

ネットワーク
コントローラー 内蔵のインテルI219LM

メモリ内蔵3 KB受信バッファおよび3 KB送信バッファ

サポートされるデータレート : 10/100/1000 Mb/秒

準拠規格 : IEEE 802.1as/1588、802.1p、802.1Q、802.3、802.3ab、802.3az、802.3i
802.3u、802.3x、802.3z

最大32個のプログラマブルフィルター

バスアーキテクチャPCIe 1.0 x1およびSMBus

UEFIおよびPXEブートROMのサポート

ネットワーク転送速度 :

10BASE-T (半二重) 10 Mb/秒

10BASE-T (全二重) 20 Mb/秒

100BASE-TX (半二重) 100 Mb/秒

100BASE-TX (全二重) 200 Mb/秒

1000BASE-T (全二重) 2000 Mb/秒

管理機能 : WOL (最大省電力を含むすべての電源状態)、自動MDIクロスオーバー、PXE、RSS、高度なケーブル診断、AMT 11.20のサポート、vPro準拠

1 GbE用の内蔵のインテルX722

サポートされるデータレート : 1000 Mb/秒

準拠規格 : IEEE 802.1as/1588v2、802.1p、802.1Q、802.3、802.3ab、802.3az、802.3x

システム技術仕様

最大16個のUDP/TCPプログラマブルフィルター
 バスアーキテクチャ：PCIe 3.0
 UEFIおよびPXEブートROMのサポート
 インテルiWARPのサポート（RDMA）
 ネットワーク転送速度：
 1000BASE-T（全二重）2000 Mb/秒
 管理機能：WOL（最大省電力を除く）、自動MDIクロスオーバー、PXE、クワッド
 ハッシュフィルタリング、RSS、高度なケーブル診断

PCI-Xコネクタ

なし

PCIカードガイド

あり

ウェイク オンLAN

あり（両方のコネクタ）

内蔵Trusted Platform Module

TPM（Trusted Platform Module）2.0（Infineon SLB 9670）

Common Criteria EAL4+認定

ファームウェアv7.80によりFIPS 140-2認定モードに交換可能

TPM認定製品のリスト：

<https://trustedcomputinggroup.org/membership/certification/tpm-certified-products/>（英語サイト）

CG TPM認定製品のリスト：

[Http://www.trustedcomputinggroup.org/certification/tpm-certified-products/](http://www.trustedcomputinggroup.org/certification/tpm-certified-products/)（英語サイト）**IEEE1394コネクタ****前面**

なし

背面

なし

内部

なし

USBコネクタ**前面**

スタンダードフロントI/Oモジュール：USB 3.1 Gen1 × 4（左端のポートは充電機能付き）

プレミアムフロントI/Oモジュール：USB 3.1 Gen1 × 2、USB 3.1 Gen2 Type-C × 2（左端のポートは充電機能付き）

背面

USB 3.0 Gen1 Type A × 6

内部

1つの20ピン シュラウド コネクタで使用可能なUSB 3.0 Gen1 × 1。このヘッダーはUSBメディアカードスロットをサポートします。

USB 3.1 G1シングルポートヘッダー × 1

USB 2.0シングルポートヘッダー × 1

USB 2.0デュアルポートヘッダー × 1

HD内蔵オーディオ

Realtek ALC221

フラッシュROM

あり

CPUファンヘッダー

CPUファン用のヘッダー × 2

メモリファンヘッダー

ヘッダー × 2

シャーシファンヘッダー

背面シャーシファンヘッダー × 1

前面PCIファンヘッダー

前面ファンヘッダー × 1および補助ファンヘッダー × 1

前面ユーザーインターフェイスヘッダー

電源ボタン、電源およびHDD動作ランプ、USBポート用の電源

前面オーディオヘッダー

FIOヘッドセット/マイクおよびスピーカー

CMOSバッテリーホルダー

あり

-リチウム**内蔵Trusted Platform Module**

TPM（Trusted Platform Module）2.0（Infineon SLB 9670）

Common Criteria EAL4+認定

ファームウェアv7.80によりFIPS 140-2認定モードに交換可能

TPM認定製品のリスト：

<https://trustedcomputinggroup.org/membership/certification/tpm-certified-products/>（英語サイト）

システム技術仕様

電源装置ヘッダー	あり
パスワードクリア ジャンパー	あり
シリアルポート	あり。背面パネル上
パラレルポート	なし
キーボード/マウス	あり

電源装置	1125 W/1275 W*/1450 W* 90%効率、カスタムPSU (ワイドレンジ、アクティブPFC)	1450 W/1550 W*/1700 W* 90%効率、カスタムPSU (ワイドレンジ、アクティブPFC)
動作電圧範囲	90 ~ 269 VAC	90 ~ 269 VAC
定格電圧範囲	100 ~ 127VAC 200 ~ 240 VAC	118 VAC 100 ~ 127VAC 200 ~ 240 VAC
定格周波数	50 ~ 60 Hz	400 Hz 50 ~ 60 Hz
動作周波数範囲	47 ~ 66 Hz	393 ~ 407 Hz 47 ~ 66 Hz
定格入力電流	12A @ 100 ~ 127 VAC 10A @ 200 ~ 240 VAC	12A @ 118 VAC 16A @ 100 ~ 127 VAC 16A @ 118VAC 10A @ 200 ~ 240 VAC
放熱 (構成/ソフトウェアによって異なります)	標準 = 2419 btu/時 最大1 = 4626 btu/時 最大2 = 5001 btu/時 最大3 = 5560 btu/時	標準 = 2970 btu/時 最大1 = 5962 btu/時 最大2 = 6080 btu/時 最大3 = 6519 btu/時

電源装置ファン	(2) 空冷ファン可変速	(2) 空冷ファン可変速
国際エネルギー スターへの準拠 (構成によって異なります)	あり	あり
電源供給装置の効率	90%効率	90%効率

Z8 G4 1125W (200 V の入力電圧で 1450 W) 電源供給装置の効率に関するレポートについては、このリンクを参照してください：
https://plugloadsolutions.com/psu_reports/HP%20Inc_DPS-PS-1125BB%20A_1125W_ECOS%204825_Report.pdf
 (英語サイト)

Z8 G4 1450W (200 V の入力電圧で 1700 W) 電源供給装置の効率に関するレポートについては、このリンクを参照してください：
https://plugloadsolutions.com/psu_reports/HP%20Inc_DPS-1450AB%20A_1450W_ECOS%204826_Report.pdf
 (英語サイト)

115 VでFEMPスタンバイ電源準拠 (S5で2 W未満 - 電源切断)	あり	あり
230 VでEuP準拠 (S5で0.5 W未満 - 電源切断)	あり	あり
220 VでCECP準拠 (S3で4 W未満 - RAMにサスペンド)	あり。構成によって異なります	あり。構成によって異なります
スリープモードでの電力消費 (国際エネルギー スター®の定義どおり) - RAMにサスペンド (S3) (すぐに利用可能なPC)	未定	未定

システム技術仕様

内蔵セルフ テスト ランプ	あり	あり
耐サージ機能付フルレ ンジ連続供給電源装置 (最大2000 Vの電力 サージに耐えます)	あり	あり

* 入力電圧の制限があります

注 : 1125 W (200 Vの入力電圧で1450 W) 電源装置はまた、入力電圧が105 Vを超える場合に1275 Wの出力電力を供給することもできます。入力電圧が105 V未満であっても、何らかの理由により90 Vを超える場合、引き出される最大出力は1125 Wになります。1275 Wの出力電力が必要な場合は、無停電電源装置 (UPS) の使用を強くおすすめします。

1125 W電源装置はまた、入力電圧がすべての条件で180 Vを超える場合に1450 Wの出力電力を供給することもできます。

注 : 1450 W (200 Vの入力電圧で1700 W) 電源装置はまた、入力電圧が105 Vを超える場合に1550 Wの出力電力を供給することもできます。入力電圧が105 V未満であっても、何らかの理由により90 Vを超える場合、引き出される最大出力は1450 Wになります。1550 Wの出力電力が必要な場合は、無停電電源装置 (UPS) の使用を強くおすすめします。

1450 W電源装置はまた、入力電圧がすべての条件で180 Vを超える場合に1700 Wの出力電力を供給することもできます。

AUXイン (オーディオ)	なし
CMOSクリア ボタン	あり
マルチベイ ヘッダー	なし
内蔵Gigabit Ethernet	あり。デュアルポート
アクセスパネルソレ ノイドロック ヘッダー	なし
アクセスパネル侵入 センサーヘッダー	あり。前面UI (コントロールパネル) ケーブルヘッダーの一部
メモリファン コネクタ	あり。ブラインドメイト

システム技術仕様

システム構成

Z8 G4構成例#1	プロセッサ情報	インテルXeon 3106 1.7 2133 8C 85 1stCPU × 1					
	メモリ情報	16GB DDR4-2666 (2x8GB) RegRAM CPU1					
	グラフィックス情報	NVIDIA Quadro P600 1st GFX × 1					
	ディスク/オプティカル/ディスクレット	256GB SATA 1st SSD × 1/DVD-ROM SATA × 1					
	電源装置	1125 W 90%カスタムPSU					
	その他	-					

エネルギー消費	115 VAC		230 VAC		100 VAC	
	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効
Windowsアイドル (S0)	75.4		74.8		75.7	
Windowsビジネ標準 (S0)	122.04		111.9		113.6	
Windowsビジネ最大 (S0)	125.4		124.6		126.6	
スリープ (S3)	6.22	6.26	6.26	6.26	6.33	6.25
オフ (S5)	4.23	4.19	4.19	4.16	4.13	4.12
ゼロパワーモード (ErP)	0.31		0.40		0.29	

放熱効率 (btu/時)	115 VAC		230 VAC		100 VAC	
	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN無効	LAN有効
Windowsアイドル (S0)	257.5		255.3		258.5	
Windowsビジネ標準 (S0)	416.4		382.0		387.6	
Windowsビジネ最大 (S0)	427.9		425.1		432.0	
スリープ (S3)	21.2	21.1	21.3	21.2	21.6	21.3
オフ (S5)	14.4	14.0	14.3	14.2	14.1	14.1
ゼロパワーモード (ErP)	1.04		1.38		0.99	

Z8 G4構成例#2	プロセッサ情報	インテルXeon 4114 2.2 2400 10C 85 1stCPU × 2					
	メモリ情報	48GB DDR4-2666 (6x8GB) RegRAM CPU2					
	グラフィックス情報	NVIDIA Quadro P2000 1st GFX × 1					
	ディスク/オプティカル/ディスクレット	512GB SATA 1st SSD × 4/DVD-ROM SATA × 1					
	電源装置	1125 W 90%カスタムPSU					
	その他	-					

エネルギー消費	115 VAC		230 VAC		100 VAC	
	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効
Windowsアイドル (S0)	105.2		103.3		102.5	
Windowsビジネ標準 (S0)	257.4		246.3		260.9	
Windowsビジネ最大 (S0)	296.2		289.9		297.6	
スリープ (S3)	8.46	8.35	8.57	8.45	8.58	8.57
オフ (S5)	4.15	4.14	4.31	4.19	4.21	4.15
ゼロパワーモード (ErP)	0.31		0.40		0.29	

放熱効率 (btu/時)	115 VAC		230 VAC		100 VAC	
	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN無効	LAN有効
Windowsアイドル (S0)	359.0		352.5		349.8	
Windowsビジネ標準 (S0)	878.3		840.5		890.2	
Windowsビジネ最大 (S0)	1010.7		989.1		1015.6	
スリープ (S3)	28.8	28.5	29.2	28.8	29.2	29.2
オフ (S5)	14.1	14.1	14.6	14.2	14.3	14.1
ゼロパワーモード (ErP)	1.04		1.36		0.99	

システム技術仕様

Z8 G4構成例#3	プロセッサ情報	インテルXeon 5120 2.2 2400 14C 105 1stCPU × 2					
	メモリ情報	96GB DDR4-2666 (12x8GB) RegRAM CPU2					
	グラフィックス情報	NVIDIA Quadro P4000 1st GFX × 1					
	ディスク/オプティカル/ディスクレット	2TB 7200 RPM SATA 1st HDD × 4/DVDRW SATA × 1					
	電源装置	1125 W 90%カスタムPSU					
	その他	-					
エネルギー消費		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN有効
	Windowsアイドル (S0)	125.7		123.6		125.8	
	Windowsビジネ標準 (S0)	340.7		332.9		343.7	
	Windowsビジネ最大 (S0)	417.1		411.8		426.1	
	スリープ (S3)	9.28	9.10	9.24	9.15	9.49	9.26
	オフ (S5)	4.15	4.14	4.32	4.10	4.21	4.16
	ゼロパワーモード (ErP)	0.31		0.41		0.30	
放熱効率 (btu/時)		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN有効	LAN無効	LAN有効
	Windowsアイドル (S0)	429.3		422.0		429.5	
	Windowsビジネ標準 (S0)	1162.7		1136.0		1172.9	
	Windowsビジネ最大 (S0)	1423.4		1405.3		1453.9	
	スリープ (S3)	31.6	31.0	31.5	31.2	32.4	31.5
	オフ (S5)	14.1	14.1	14.7	13.9	14.3	14.2
	ゼロパワーモード (ErP)	1.05		1.38		1.03	
Z8 G4構成例#4	プロセッサ情報	Intel Xeon 6152 2.1 2666 22C 140 CPU × 2					
	メモリ情報	192GB DDR4-2666 (24x8GB) RegRAM CPU					
	グラフィックス情報	NVIDIA Quadro P5000 GFX × 2					
	ディスク/オプティカル/ディスクレット	1 TB SATA SSD × 6/1x DVDRW SATA					
	電源装置	1125 W 90%カスタムPSU					
	その他	-					
エネルギー消費		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN有効
	Windowsアイドル (S0)	161.1		157.8		160.4	
	Windowsビジネ標準 (S0)	524.7		500.7		496.1	
	Windowsビジネ最大 (S0)	644.2		624.2		652.7	
	スリープ (S3)	10.3	10.2	10.2	10.1	10.1	10.1
	オフ (S5)	4.14	4.01	4.19	4.19	4.16	4.15
ゼロパワーモード (ErP)	0.31		0.41		0.31		
放熱効率 (btu/時)		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN有効	LAN無効	LAN有効
Windowsアイドル (S0)	549.6		538.4		547.5		

システム技術仕様

Windowsビジー標準 (S0)	1790.4		1708.6		1692.6	
Windowsビジー最大 (S0)	2198.1		2129.8		2227.0	
スリープ (S3)	35.3	34.9	35.0	34.7	34.5	134.3
オフ (S5)	14.1	13.6	14.3	14.3	14.2	14.1
ゼロパワーモード (ErP)	1.06		1.39		1.04	

Z8 G4構成例#5	プロセッサ情報	Intel Xeon 6136 3.0 2666 12C 150 CPU × 2
	メモリ情報	768GB DDR4-2666 (24x32GB) RegRAM CPU2
	グラフィックス情報	NVIDIA Quadro P6000 GFX × 2
	ディスク/オプティカル/ディスクレット	HP Z Turbo Quad Pro 4x1TB + 1 TB SATA SSD × 4/DVDRW SATA × 1
	電源装置	1450 W 90%カスタムPSU
	その他	-

エネルギー消費		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN有効
	Windowsアイドル (S0)	194.0		192.6		197.0	
	Windowsビジー標準 (S0)	640.2		622.0		647.0	
	Windowsビジー最大 (S0)	788.0		761.3		800.6	
	スリープ (S3)	21.1	19.7	19.7	18.8	21.3	19.8
	オフ (S5)	4.24	4.22	4.53	4.51	4.24	4.21

放熱効率 (btu/時)		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN有効	LAN無効	LAN有効
	Windowsアイドル (S0)	662.1		657.2		672.3	
	Windowsビジー標準 (S0)	2184.3		2122.3		2207.7	
	Windowsビジー最大 (S0)	2688.8		2597.8		2731.7	
	スリープ (S3)	72.3	67.5	67.5	64.1	72.6	67.7
	オフ (S5)	14.4	14.4	15.4	15.4	14.4	14.3

注：電力消費の測定値は、Intelターボブーストテクノロジーを活用していません。その結果、電力消費の測定値は、より高くなる場合があります。

定格騒音規制

システム構成 (エントリレベル)	プロセッサ情報	インテル® Xeon® Gold 6134プロセッサ-3.2GHz 8C CPU × 2
	メモリ情報	96GB (12x8GB) DDR4-2666 ECCメモリRDIMM
	グラフィックス情報	NVIDIA® Quadro® P400 2GB × 1
	ディスク/オプティカル	500GB SATA 7200RPM 3.5インチHDD × 1/HP 9.5 mmスリムブルーレイディスクライター × 1
	電源装置	1125 W

定格騒音規制 (ISO 7779およびISO 9296 準拠)		サウンド出力 (LWAd、ベル)	デスク側のサウンド圧力 (LpAm、デシベル)
	アイドル	3.6	19
	ハードディスクドライブ動作時 (ランダム読み取り)	3.7	19

システム技術仕様

システム構成 (ミッドレンジ)	プロセッサ情報	インテル® Xeon® Gold 6146 プロセッサ-3.2GHz 12C CPU × 2
	メモリ情報	384GB (24×16GB) DDR4-2666 ECCメモリ RDIMM
	グラフィックス情報	NVIDIA® Quadro® P6000 24GB × 1
	ディスク/オプティカル	300GB 12Gb/s 15KRPM SAS HDD × 2/HP 9.5 mm スリム ブルーレイ ディスクライター × 1
	電源装置	1450 W

定格騒音規制 (ISO 7779およびISO 9296 準拠)		サウンド出力 (LWAd、ベル)	デスク側のサウンド圧力 (LpAm、デシベル)
	アイドル		3.6
ハードディスクドライブ動作時 (ランダム読み取り)		3.8	23

環境データ

環境条件	動作保証温度	動作時：5 ~ 35°C 非動作時：-40 ~ 60°C
	湿度	動作時：8 ~ 85%のRH（結露なし） 非動作時：8 ~ 90%のRH（結露なし）
	動作保証高度	動作時：3,048 m 非動作時：9,144 m
	動力（新規）	衝撃 動作時：1/2正弦波：40 g、2 ~ 3 ms（~ 62 cm/秒） 非動作時：1/2正弦波：160 cm/秒、2 ~ 3 ms（~ 105 g） 方形波：422 cm/s、20 g 注：値は1回の衝撃に対するものであり、繰り返し衝撃に対しては当てはまりません。
	冷却	振動 ランダム動作時：0.5 g (rms)、5 ~ 300 Hz、最大0.0025 g ² /Hz 非ランダム動作時：2.0 g (rms)、5 ~ 500 Hz、最大0.0150 g ² /Hz 注：値は連続振動には当てはまりません。 1524 m (5,000フィート) を超える海拔では、最大動作温度は3048 m (10,000フィート) まで、高度が305 m (1,000フィート) 増加するごとに1°C (1.8°F) 下がります。

物理セキュリティおよび保守性

アクセスパネル	工具不要 システム ボードおよびメモリ情報が含まれます。
オプティカルドライブ	工具不要。2台目のオプティカルドライブには5.25"ベイ キャリアが必要です。
ハードディスクドライブ	工具不要
拡張カード	工具不要
プロセッサ ソケット	工具不要
青色のユーザー タッチポイント	あり。工具不要の内蔵シャーシ コンポーネント上。

システム技術仕様

色分けされたケーブルおよびコネクタ	あり
メモリ	工具不要
システムボード	工具不要。前面カードガイドおよび上部メモリファンホルダーで固定
コンピューター前面のデュアルカラーの電源およびHD LED	なし
構成レコードソフトウェア	あり
画面上の過熱警告	あり。温度注意および温度重大がWMIインターフェイス経由で提供されます。HPPAなどのツールは重大や注意の状態を表示できます。
復元用CD/DVDセット	コンピューターを最初の工場出荷時イメージに復元します。HPサポートから入手できます。
デュアル機能の前面電源スイッチ	あり。4秒押し続けるとフェイルセーフの電源切断が発生します
南京錠サポート	なし
ケーブルロックサポート	あり。ケンジントン社製ケーブルロック（オプション）：システム全体の盗難のみを防止します。システム背面の3 mm × 7 mmスロット
ユニバーサルシャーシクランプロックサポート	なし
ソレノイドロックおよびフードセンサー	なし
背面ポート制御カバー	なし
シリアル、USB、オーディオ、ネットワーク、ポートの有効/無効制御	あり。USBコントロールは前面、背面、および内部にあります
リムーバブルメディアの書き込み/起動制御	なし
電源投入時パスワード（Power-on Password）	あり。権限のないユーザーがワークステーションを起動できないようにします
セットアップパスワード	あり。権限のないユーザーがワークステーションの構成を変更できないようにします
システムPCA上の3.3 V Aux電源ランプ	なし
NIC LED（内蔵）（緑色およびオレンジ色）	あり
CPUおよびヒートシンク	ヒートシンクを取り外すにはT30型のネジ回しが必要です。CPUはヒートシンクに工具不要の留め具で取り付けられています
電源装置診断LED	あり
前面電源ボタン	あり
前面電源ランプ	あり。白色（正常）、赤色（障害）
前面のハードディスクドライブ動作ランプ	あり。白色
前面のODD動作ランプ	あり
内蔵スピーカー	あり
システム/緊急ROMフラッシュリカバリ	破損したシステムBIOSをリカバリします
冷却装置	空冷式強制対流
電源装置ファン	両側の吸気口空冷ファン × 2
CPUヒートシンクファン	80 mm × 25 mm 5ワイヤーPWM（各CPU）

システム技術仕様

シャーシファン	背面：120 mm × 38 mm 前面：120 mm × 25 mm (PCIeゾーン)
メモリヒートシンクファン	前面92 mm × 25 mm (上部メモリバンク)、前面80 mm × 25 mm (下部メモリバンク)
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (HP PCハードウェア診断)	[HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)]によって、多くのコンポーネントに対してオペレーティングシステム外でハードウェアレベルのテストを実施できます。この診断はPCの再起動時に最初にESCキー、次にF2キーを押して起動でき、HPサポートからのダウンロードとして入手できます。
アクセスパネルキーロック	あり。アクセスパネルおよびすべての内蔵コンポーネント（オプティカルおよびストレージデバイスを含む）の取り外しを防止します
ACPI対応ハードウェア	ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)。 <ul style="list-style-type: none">システムは低電力モードから復帰できます。システムの電力消費を制御して、個々のカードおよび周辺機器を、システムの他の要素に影響を及ぼすことなく、低電力または電源切断状態にすることを可能にします。
Trusted Platform Module チップ	あり
内蔵シャーシハンドル	あり、前面および背部
電源装置	工具不要、リアアクセス直接接続（ブラインドメイト）
PCIeカード固定	あり。工具不要 背面（すべて） 中央（フルハイトカード） 前面（エクステンダー付きフルレングスカード）
フラッシュROM	あり。SPI ROM
ボード上の診断電源スイッチランプ	あり
パスワードクリアジャンパー	あり
CMOSクリアボタン	あり
CMOSバッテリーホルダー	あり
DIMMコネクタ	あり
BIOS	
BIOS 32ビットサービス	Standard BIOS 32-bit Service Directory Proposal v0.4 BIOSは32および64ビットオペレーティングシステムをサポートします。
PCI 3.0サポート	業界標準インターフェイス経由でのPCI Expressの完全BIOSサポート。
ATAPI	ATAPI Removable Media Device BIOS Specificationバージョン1.0。
BBS	BIOS Boot Specification v1.01。
WMIサポート	WMIは、マイクロソフトによるWBEM (Web-Based Enterprise Management) のWindows向けの実装です。WMIは、DMTF (Distributed Management Task Force) CIM (Common Information Model) およびWBEM仕様に完全に準拠しています。
BIOS Boot Spec 1.01+	ワークステーションの起動方法および起動元デバイスを細かく制御できます。
BIOS電源投入	ユーザーは、システムの電源を入れる特定の日付および時刻を定義できます。
ROMベース[コンピューターセットアップ (F10) ユーティリティ]	BIOSによって制御されるシステム構成の設定を確認およびカスタマイズします。
ビデオによるシステム/緊急ROMフラッシュリカバリ	破損したフラッシュROM内のシステムBIOSをリカバリします。

システム技術仕様

複製セットアップ	USBフラッシュ デバイス上の読み取り可能なファイル (HpSetup.txt) にBIOS設定を保存します。その後、BiosConfigurationUtility.exeユーティリティは、[コンピューター セットアップ (F10) ユーティリティ]を起動することなく、展開されたシステムでこれらの設定を複製できます。
SMBIOS	システム管理情報用のSystem Management BIOS 2.8。
起動制御	サポート対象のデバイスでリムーバブルメディアからの起動を無効にします。
メモリ変更警告	メモリが取り除かれたり変更されたりした場合、管理コンソールに警告します。
温度警告	シャーシ内の温度状態を監視します。3つのモード： <ul style="list-style-type: none">• [NORMAL] (正常) - 正常の温度範囲。• [ALERTED] (警告) - 過熱が検出されています。シャットダウンを回避する、またはより円滑なシステムシャットダウンを提供するためのアクションを行えるよう、フラグが立てられます。• [SHUTDOWN] (シャットダウン) - 過熱が発生しています。ハードウェア コンポーネントの損傷が発生する前に、警告なしでコンピューターを自動的にシャットダウンします。
リモートROMフラッシュ機能	中央のネットワーク コンソールから安全でフェイルセーフのROMイメージ管理を提供します。
ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)	システムは低電力モード (スリープモード) に入り、そのモードから復帰できます。オペレーティングシステムは、動的なワークロードに基づいてシステムの電力消費を制御できます。個々のカードおよび周辺機器を、システムの他の要素に影響を及ぼすことなく、低電力または電源切断状態にすることを可能にします。64ビットオペレーティングシステムとの完全な互換性のためにACPI 5.0をサポートします。
オーナーシップタグ	BIOSスプラッシュ画面に表示される、不揮発性メモリに記憶されるユーザー定義の文字列。
リモート復帰/リモートシャットダウン	システム管理者は、リモート場所から、クライアント コンピューターの電源投入、再起動、および電源切断を行うことができます。
すぐに利用可能なPC (RAMにサスペンド-ACPIスリープ状態S3)	短い再開時間により、非常に低い電力消費を可能にします。
F12によるリモートシステムインストール (PXE 2.1) (サーバーからのリモート起動)	新規または既存のシステムはネットワークを介して起動し、オペレーティングシステムを含むソフトウェアをダウンロードできます。
ROMリビジョンレベル	[コンピューター セットアップ (F10) ユーティリティ]でシステムBIOSリビジョンレベルを報告します。バージョンは、業界標準インターフェイス (SMBIOSおよびWMI) を介して利用できるように、管理SWアプリケーションはこの情報を使用して報告できます。
システムボードリビジョンレベル	管理ソフトウェアはシステムボードのリビジョンレベルを読み取ることができます。リビジョンレベルは、ハードウェアにデジタルでエンコードされており、変更できません。
起動診断 (Power-On Self Test)	選択可能なテストレベルで、起動時のシステム状態を評価します。
新規ハードウェアインストール時の自動セットアップ	システムは、新規ハードウェアの追加を自動検出します。
キーボード不要の操作	システムをキーボードなしで起動できます。
ローカライズされたROMセットアップ	共通BIOSイメージは、[コンピューター セットアップ (F10) ユーティリティ]のメニューを、キーボードマッピングがローカライズされた14言語でサポートします。
アセットタグ	ユーザーまたはMISが不揮発性メモリ内の一意のタグ文字列を設定します。
スロットごとの制御	I/Oスロットパラメーター (オプションのROM有効/無効、バス遅延) を個別に構成できます。
アダプティブ冷却	最適な音響を実現するために、検出されたハードウェア構成に従って制御パラメーターが設定されます。
起動前の診断	(画面表示前の) 重大なエラーは、電源ランプのピーブ音および点滅によって報告されます。
業界標準仕様サポート	
業界標準	BIOSによってサポートされるリビジョン
UEFI仕様リビジョン	2.5
ACPI	Advanced Configuration and Power Management Interface、バージョン5.0

システム技術仕様

ATA (IDE)	ATA/ATAPI-6 (AT Attachment 6 with Packet Interface)、リビジョン3b
CD起動	"El Torito" Bootable CD-ROM Format Specificationバージョン1.0
EDD	- Enhanced Disk Drive Specificationバージョン1.1 - BIOS Enhanced Disk Drive Specificationバージョン3.0
EHCI	Enhanced Host Controller Interface for Universal Serial Bus、リビジョン1.0
PCI	PCI Local Bus Specification、リビジョン2.3 PCI Power Management Specification、リビジョン1.1 PCI Firmware Specification、リビジョン3.0、ドラフト0.7
PCI Express	PCI Express Base Specification、リビジョン2.0 PCI Express Base Specification、リビジョン3.0
PMM	POST Memory Manager Specification、バージョン1.01
SATA	Serial ATA Specification、リビジョン1.0a Serial ATA 3 Gb/s : Serial ATA Specification、リビジョン2.5 Serial ATA 6 Gb/s : Serial ATA Specification、リビジョン3.0
SPD	PC SDRAM Serial Presence Detect (SPD) Specification、リビジョン1.2B
TPM	Trusted Computing Group TPM Specificationバージョン2.0 (Infineon SLB 9665)。 Common Criteria EAL4+認定。 TCG TPM認定製品のリスト： http://www.trustedcomputinggroup.org/certification/tpm-certified-products/ (英語サイト)
UHCI	Universal Host Controller Interface Design Guide、リビジョン1.1
USB	Universal Serial Busリビジョン1.1仕様 Universal Serial Busリビジョン2.0仕様 Universal Serial Busリビジョン3.0仕様
SMBIOS	System Management BIOS Reference Specification、バージョン2.8 外部BIOSシミュレーターについては、次を参照してください： http://h20464.www2.hp.com/index.html (英語サイト)

社会的および環境に対する責任

エコラベル認定および宣言 本製品は以下の承認を受けている、または承認の認定途中です。これらの評価のラベルが1つまたは複数貼付されている場合があります。

- 国際エネルギー スター® (特定の構成で利用可能な省エネルギー機能-Windowsのみ)
- 米国FEMP (Federal Energy Management Program)
- China Energy Conservation Program
- ECO宣言 (TED)

Z8 G4は、米国およびカナダで登録済みのEPEAT® Goldです。EPEAT®の登録は国によって異なります。各国の登録状況については、<http://www.epeat.net> (英語サイト) をご覧ください。太陽発電機のオプション製品については、HPのサードパーティ オプション ストア (<http://www.hp.com/go/options> (英語サイト)) でキーワード「generator」を検索してください。

バッテリー

本製品のバッテリーは、EU Directive 2006/66/EC
バッテリーサイズに準拠しています：CR2032 (コイン型バッテリー)
バッテリーの質量：3 g
バッテリーの種類：リチウム メタル

本製品のバッテリーには以下は含まれてません。

システム技術仕様

- 質量で5 ppmを超える水銀
- 質量で10 ppmを超えるカドミウム
- 質量で40 ppmを超える鉛

制限された原料使用

本製品は、HP環境関連一般仕様書（GSE）に規定されている原料制限に従っています。

HP Inc.は、European UnionのRoHS（Restriction of Hazardous Substances）Directiveを含め、すべての適用される環境法および規制に準拠するように努めています。HPの目標は、RoHS Directiveの要件を世界各国で満たすことによって、準拠義務を超えることです。

低ハロゲンに関する声明

本製品は、電源コード、外部ケーブル、および周辺機器を除き、低ハロゲンです。お客様が構成可能な次の内蔵コンポーネントは、低ハロゲンではない場合があります：3 ½インチSAS HDD。購入後に取得する保守部品は、低ハロゲンではない場合があります。

廃棄管理およびリサイクル

HP Inc.では、多くの地域で、廃棄するHP製品の返却およびリサイクルプログラムを提供しています。製品をリサイクルする場合は、<http://www.hp.com/jp/hardwarerecycle/>にアクセスするか、最寄りのHP販売オフィスにお問い合わせください。HPに返却された製品は、責任を持ってリサイクル、復元、または廃棄されます。本製品は、適切に廃棄された場合、質量で90%以上リサイクル可能です。

HP Inc.の環境情報

HPの環境に対する取り組みについて詳しくは、以下を参照してください。

[持続可能性レポート](#)

エコラベル認定：

<http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html>（英語サイト）

ISO 14001証明書：<http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/operations/envmanagement.html>（英語サイト）

追加情報

- 本HP製品は、WEEE（Waste Electrical and Electronic Equipment）Directive – 2002/96/ECに準拠するように設計されています。[製品の取り外しの手順](#)
- 本製品で使用されている25グラムを超えるプラスチック部品には、ISO 11469およびISO1043に従ってマークが付けられています。
- 本製品は、適切に廃棄された場合、90%以上リサイクル可能です

梱包

HPワークステーション製品の梱包は、[HPの環境に関する一般的な仕様](#)を満たしています。

- HP標準011-1（環境に関する一般的な仕様）に規定されている制限物質は含まれていません
- オゾン破壊物質（ODS）は含まれていません
- 指定されているすべての重金属（鉛、水銀、カドミウム、または六価クロム）は、合計100 ppmを超える量が含まれていません。
- 梱包材料では使用済みのリサイクルされた材料を最大限使用しています。
- すべての梱包材料はリサイクル可能です
- すべての梱包材料は、分解しやすいように設計されています
- 輸送の燃料効率を向上させるために、梱包品のサイズと質量が削減されています
- プラスチックの梱包材料には、ISO 11469およびDIN 6120標準のフォーマットに従いマークが付けられています

梱包材料

内部

クッションおよびプラスチックバッグは、低密度ポリエチレン（LDPE）で作られています。

外部

外側の箱、オプション製品の箱、および挿入物は段ボール板紙で作られています。

管理機能



システム技術仕様

業界標準仕様

本製品は、管理機能に関する以下の業界標準仕様を満たしています。

- DASH 1.1 (Intel® LAN on motherboard経由)

インテル® アクティブ・
マネージメント・
テクノロジー (AMT)

Intel® AMT (Active Management Technology) 11.20

システムの状態または電源の状態にかかわらず、ネットワーク接続されたクライアント システムをリモート検出、修復、および保護するための最新で最も効果的なツールをIT管理者に提供する、リモート管理機能の高度なセット。AMT 11.20には、以下の高度な管理機能が含まれています。

- 電源管理 (投入、切断、リセット、適切なシャットダウン、スリープ、およびハイバネーション)
 - 最大省電力でのサポート (シャットダウンおよびハイバネーションモード)
- ハードウェア インベントリ (BIOSおよびファームウェア リビジョンを含む)
- ハードウェア警告
- エージェント プレゼンス
- システム防御フィルター
- SOL (Serial Over LAN)
- USBリダイレクト (メディアリダイレクト)
- ME WOL (ウェイク オンLAN)。最大省電力が有効になっている場合も機能
- DASH 1.1準拠
- IPv6サポート
- Fast Call for Help - ファイアウォール内部または外部のクライアントは、BIOS画面、定期的な接続、または警告によってトリガーされる接続を介して、ヘルプへの通話を開始できます。
- リモートからの定期保守 - システムが保守のためにITまたはサービス プロバイダー コンソールに接続する時期をあらかじめスケジュールします。
- リモート警告 - 問題が発生した場合にITまたはサービス プロバイダーに自動的に警告します。
- アクセスモニター - セキュリティ要件をサポートするためにIntel® AMTのアクションを監視します。
- PCアラームクロック
- Microsoft NAPサポート
- ホストベースセットアップおよび構成
- 管理エンジン (ME) ファームウェア ロールバック
- ローカル時間のUTCとの同期
- リモート メモリ ダンプ コマンド - デバッグ用のメモリ ダンプを作成します。

Intel® vPro® テクノロジー

HP Z8 G4 Workstationは、以下のように構成されている場合、Intel® vProテクノロジーをサポートします。

- Intel® vPro® テクノロジー搭載のインテル® Xeon® プロセッサ E5-1600 v5またはE5-2600 v5製品ファミリ
- インテル® C622 チップセット
- インテル® I219LM GbE LAN

リモート管理ソフトウェア
ソリューション

HP Z8 G4 Workstationは、以下のリモート管理ソフトウェア コンソールでサポートされています。

- LANDesk Management Suite (HP推奨ソリューション)
- Microsoft System Center Configuration Manager
- HP Client Automation Enterprise

管理ニーズに関する質問またはサポートについては、<http://www.hp.com/go/easydeploy/> (英語サイト) を参照してください。

System Software Manager

SSMに関する質問またはサポートについては、次を参照してください：<http://www.hp.com/go/ssm/> (英語サイト) を参照してください

サービス、サポート、
および保証

オンサイト保証およびサービス (注1)：3年間の限定された保証およびサービス提供は、部品および作業に対するサービスをオンサイトで翌営業日 (注2) に提供し、午前8時～午後5時の無料の電話サポート (注3) が含まれます。グローバル対応 (注2) により、ある国で購入し、制約のない別の国に移動した製品には、元の保証およびサービス提供がすべて引き続き適用されます。24時間365日対応のサービスに

システム技術仕様

よって、HPの保証が無効になることはありません。

注1：条件は国ごとに異なる場合があります。特定の制限および除外が適用されます。

注2：オンサイトサービスは、HPとHPの認定サードパーティプロバイダーとの間のサービス契約に従って提供される場合があります、一部の国では利用できません。グローバルサービスの応答時間は、商取引上の合理的なベストエフォートに基づき、国ごとに異なる場合があります。

注3：電話によるテクニカルサポートは、HPが構成し、HP製およびHPが認定したサードパーティ製のハードウェアおよびソフトウェアにのみ適用されます。無料通話および24時間365日対応のサポートサービスは、一部の国では利用できない場合があります。

HP Care Packサービスは、標準保証を超えてサービス契約を拡張します。サービスはハードウェア購入日から開始します。HP製品に適したレベルのサービスを選択するには、次のサイトにある[HP Care Pack Services Lookup Tool]を使用してください：<http://www.hp.com/go/lookuptool/>（英語サイト）製品ごとの詳しいHP Care Packサービス情報については、次のサイトを参照してください：<http://www.hp.com/hps/carepack/>（英語サイト）HP Care Packのサービスレベルおよび応答時間は、地域ごとに異なる場合があります。HPのサービスは、ご購入時にお客様に提供または提示される、適用可能なHPサービス使用条件に準拠します。お客様によっては該当地域の法令に従ってその他の法的権利を有することもあり、当該権利はHPサービス使用条件またはお使いのHP製品に付属のHP限定保証による影響を一切受けません。

製品変更通知

- ユーザーが定義したプロファイルに基づき、製品変更通知（PCN）および技術情報を電子メールでお客様にプロアクティブに通信するためのプログラム。
- PCNは、工場で実装されるハードウェアおよびソフトウェア変更を事前に通知して、移行を計画するための時間を提供します。
- 技術情報は、正確で効果的な問題解決を提供して、テクニカルサポートに問い合わせる必要性を大幅に減らします。

Stable & Consistent Offerings

グローバル シリーズSKU HPでは、HPワークステーションのお客様向けに、ハードウェア、ソフトウェア、ソリューションのインベーションへの取り組みの一つとして、この画期的なプラットフォーム構成の安定性をご紹介させていただきます。「HP Stable & Consistent Offerings」は、すべてのHP Zワークステーションのプラットフォームで使用期限まで機能するように設計およびテストされた一連のハードウェアおよびソフトウェアを慎重に選択し、それらを基盤として構築されています。このセクションでは、これらのコンポーネントとそれに対応するHPワークステーションのプラットフォームの互換性について概説します。

「HP Stable & Consistent Offerings」は、HPワークステーションのすべてのお客様に世界中どこでもご利用いただけ、特別なプログラムや追加のコストも一切必要ありません。HPワークステーションをカスタマイズするときにハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを選択するだけで、製品のライフサイクルを通じて同じ構成が購入できるように保証されます。

プロセッサ	製品番号	製品
	1XM69AA	インテル® Xeon® Gold 6128プロセッサ
	1XM74AA	インテル® Xeon® Silver 4114プロセッサ
	1XM76AA	インテル® Xeon® Silver 4108プロセッサ

ハードディスクドライブ	製品番号	製品
	LQ037AA	1TB SATA 7200 RPM

グラフィックス	製品番号	製品
	2TF08AA	AMD Radeon® Pro WX 3100 4GBグラフィックス

メモリ	製品番号	製品
	未定	未定

オプティカルおよびリムーバブルストレージ	製品番号	製品
	未定	未定
	未定	未定